

산 및 알칼리 내성 반도체 세정용 맞춤형 6인치 원형 Ptfе 웨이퍼 캐리어 플라워 바스켓

품목 번호: PL-CP55



소개

핵심 반도체 습식 프로세스용으로 설계된 고순도 6인치 PTFE 웨이퍼 캐리어입니다. 극한의 화학 내성과 열 안정성을 갖도록 설계된 이 맞춤형 플라워 바스켓은 생산 과정 전반의 가혹한 산성 및 알칼리성 침지 환경에서 균일한 세정과 기판 보호를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 RCA 세정	유기 및 이온 오염 물질을 제거하기 위해 SC-1 및 SC-2 용액에 웨이퍼 침지.	산화제 및 고온 염기에 대한 완벽한 내성.
습식 에칭 프로세스	불산(HF) 또는 인산을 사용한 물질 층의 선택적 제거.	정밀한 기판 위치 선정으로 웨이퍼 전체에 균일한 에칭 깊이 보장.
포토리소그래피 박리	공격적인 유기 용제 또는 피라냐 용액을 사용한 포토레지스트 층 제거.	가혹한 용제에 노출되어도 재료가 팽창하거나 열화되지 않음.
태양전지 텍스처링	효율성 향상을 위한 실리콘 웨이퍼의 대량 세정 및 표면 텍스처링.	내구성 있는 디자인으로 산업 규모의 화학 처리 업무를 견딤.
CMP 후 세정	화학 기계적 연마 후 슬러리 입자 및 화학 물질 제거.	초매끄러운 표면으로 입자 재부착을 방지하고 세정을 용이하게 함.
미량 분석 준비	농축 질산 또는 염산에 고순도 실험실 구성 요소 세정.	초미량 원소 분석을 위한 교차 오염 위험 제거.
MEMS 제작	마이크로 전자 기계 시스템 생산을 위한 특수 기판 핸들링.	맞춤형 슬롯 치수로 비표준 기판 두께 수용.

매개변수	">PL-CP55 사양
제품 식별	PL-CP55 원형 웨이퍼 캐리어 (플라워 바스켓)
재료 구성	고순도 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)
웨이퍼 크기 호환성	6인치 (150mm) 표준 (맞춤 크기 가능)
구성	원형 슬롯 바스켓 / 천공 플라워 디자인
슬롯 수 / 용량	맞춤형 (표준 옵션: 10, 25 또는 50개 슬롯)
작동 온도	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학 내성	pH 0-14 (범용 산/알칼리/용제 내성)
슬롯 너비 / 피치	사용자 사양에 따라 완전히 맞춤형
핸들 유형	통합 고정 핸들 또는 분리형 PTFE 스윙 핸들 (맞춤형)
표면 마감	CNC 가공 매끄러움 (일반적으로 Ra ≤ 0.8μm)
제작 방법	100% 정밀 CNC 가공 (맞춤형 제품)

매개변수

">PL-CP55 사양

치수

특정 습식 벤치 또는 탱크 치수에 맞게 맞춤 설계